

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年11月28日(28.11.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/241853 A1

(51) 国際特許分類:

C08L 101/00 (2006.01) C08K 9/06 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C08L 9/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/016848

(22) 国際出願日: 2024年5月2日(02.05.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-083932 2023年5月22日(22.05.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 竹口 彩香 (TAKEGUUCHI Ayaka); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 垣谷 稔(KAKITANI Minoru); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 清水 浩(SHIMIZU Hiroshi); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 谷川 隆雄(TANIGAWA Takao); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 福井 将人(FUKUI Masato); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 明比 龍史(AKEBI Ryuji); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo

(JP). 村田 裕太(MURATA Yuta); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 大塚 康平(OTSUKA Kohei); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 佐藤 直義(SATOU Naoyosi); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 畠山 寧々(HATAKEYAMA Nene); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 虎ノ門Eビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG, LAMINATE, RESIN FILM, PRINTED WIRING BOARD, AND SEMI-CONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージ

(57) Abstract: The present invention relates to: a resin composition that contains (A) a thermosetting resin, (B) at least one substance which is selected from the group consisting of a conjugated diene polymer and a derivative thereof, and which has two or more functional groups that each contain an ethylenically unsaturated bond, and (C) an inorganic filler which is surface-treated with a silane coupling agent having a functional group that contains an ethylenically unsaturated bond; a prepreg which uses this resin composition; a laminate; a resin film; a printed wiring board; and a semiconductor package.

(57) 要約: (A) 熱硬化性樹脂と、(B) 共役ジエンポリマー及びその誘導体からなる群から選択される1種以上であって、エチレン性不飽和結合を含む官能基を2個以上有するものと、(C) エチレン性不飽和結合を含む官能基を有するシランカップリング剤によって表面処理された無機充填材と、を含有する樹脂組成物、該樹脂組成物を用いたプリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージに関する。

[続葉有]

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）